



电子

优于大市（维持）

证券分析师

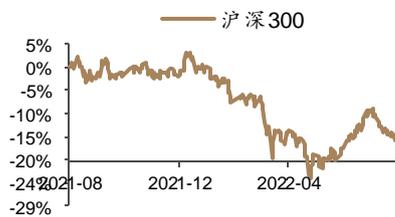
陈海进

资格编号：S0120521120001

邮箱：chenhj3@tebon.com.cn

研究助理

市场表现



相关研究

- 1.《IC 价格跟踪月报 (2022-07): 高压功率芯片渠道价格保持稳定》，2022.7.31
- 2.《汽车电子月报-销量新高，复苏强劲》，2022.7.16
- 3.《台积电 Q2 营收达指引上沿，汽车、IoT、HPC 营收环比保持较好增速》，2022.7.14
- 4.《电子月报 (台股) 2022-06: 半导体上游维持景气，消费电子下半年有望回暖》，2022.7.10
- 5.《半导体设备月报: 设备国产化率提升，静待存储大厂启动扩产招标》，2022.7.3

美国芯片法案有望加速半导体国产替代

投资要点:

- **美国总统签署《芯片与科学法案》。**2022年7月27日美国参议院以64票赞成、33票反对通过了《芯片与科学法案》(以下简称“美国芯片法案”)，而在7月28日，众议院以243票赞成、187票反对通过了这项法案。在北京时间8月9日晚，美国总统拜登正式签署该法案。
- **美国芯片法案限制获补贴企业在中国进行先进制程芯片投资。**美国芯片法案主要涵盖两个重要部分：(1) 向半导体行业提供527亿美元的资金支持，鼓励企业在美国研发和制造芯片，并为这些企业提供25%的投资税抵免；(2) 授权未来几年提供约2000亿美元的科学技术研究资金，涵盖人工智能、机器人技术、量子计算、电池技术、生物技术等诸多对未来竞争力至关重要的领域。美国芯片法案禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年，而违反禁令或未能修正违规状况的公司，可能需要全额退还联邦补助款。
- **美国法案将提升各国对半导体行业重视程度，有望加速我国半导体自主可控进展。**首先，美国法案显示了其对于半导体环节的重视，例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造，而在研发方向上也包括先进封装制造。美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。另一方面，美国芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资先进制程晶圆制造的限制。这将进一步提升半导体制造中自主可控的重要性，加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。
- **投资建议：**建议关注设备平台型公司北方华创、中微公司等，以及细分赛道领先公司，包括芯基微装、芯源微、拓荆科技、华海清科、盛美上海等；先进封装带来测试设备公司机遇，包括长川科技、华峰测控等；半导体材料中鼎龙股份、沪硅产业等
- **风险提示：**下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。

内容目录

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. 美国芯片法案获通过，预计加速我国半导体国产替代..... | 4 |
| 2. 风险提示 | 5 |

图表目录

图 1: 美国芯片法案资金分配情况 (美元)4

表 1: 美国芯片法案中资金分配细节4

1. 美国《芯片与科学法案》被正式签署，预计加速我国半导体国产替代

美国总统将签署《芯片与科学法案》。2022年7月27日美国参议院以64票赞成、33票反对通过了《芯片与科学法案》(以下简称“美国芯片法案”)，而在7月28日，众议院以243票赞成、187票反对通过了这项法案。在北京时间8月9日晚，美国总统拜登正式签署该法案。法案主要涵盖两个重要部分：

(1) 向半导体行业提供527亿美元的资金支持，鼓励企业在美国研发和制造芯片，并为这些企业提供25%的投资税抵免；

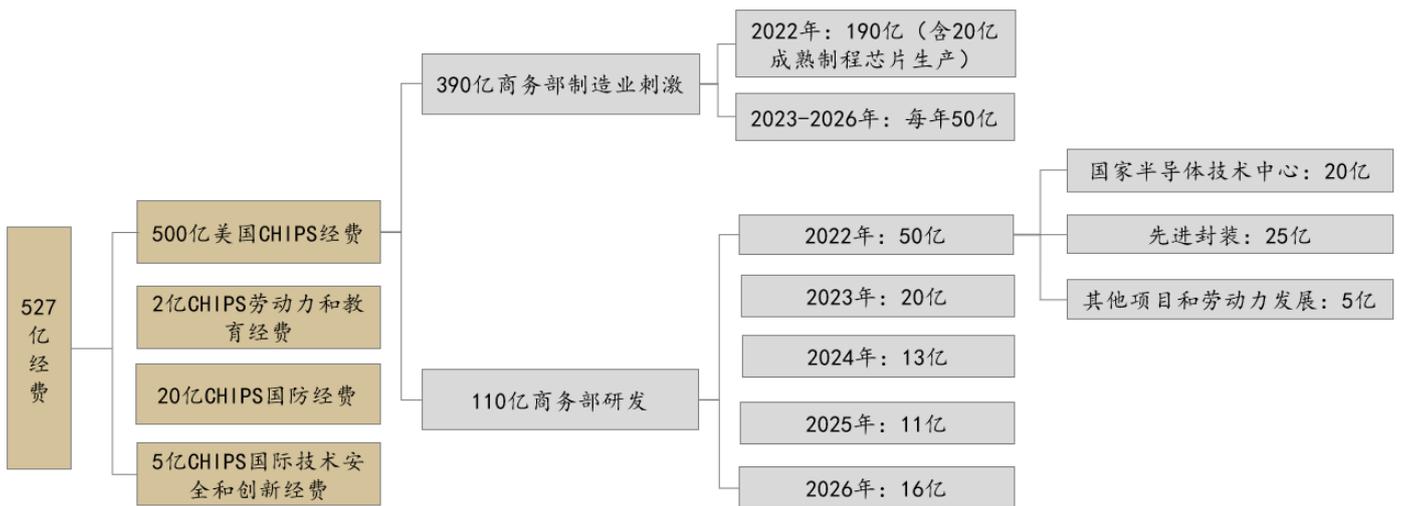
(2) 授权未来几年提供约2000亿美元的科学技术研究资金，涵盖人工智能、机器人技术、量子计算、电池技术、生物技术等诸多对未来竞争力至关重要的领域。美国芯片法案禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10年，而违反禁令或未能修正违规状况的公司，可能需要全额退还联邦补助款。

表 1：美国芯片法案中资金分配计划

| | |
|-----------------|---|
| 1. 半导体制造激励计划 | 在5年内拨款390亿美元：60亿美元可能用于直接贷款和贷款担保的成本。2022财年将拨款190亿美元，其中20亿美元用于传统芯片生产，优先考虑汽车行业等关键制造业。在先进芯片制造方面，提供25%的投资税收抵免。 |
| 2. 商业研发和劳动力发展计划 | 在5年内拨款110亿美元：包括国家半导体技术中心(NSTC)、国家先进封装制造计划以及其他研发和劳动力发展计划。其中，2022财年将拨款20亿美元用于NSTC、25亿美元用于先进封装。 |
| 3. 美国劳动力和教育基金 | 2亿美元：用提供给国家科学基金会的资金，分期五年，以促进半导体劳动力的增长。 |
| 4. 国防部国防基金 | 20亿美元：用于实施微电子军民共享计划，更快将实验室成果转化为军事和其他应用。 |
| 5. 国际技术安全和创新基金 | 5亿美元：资金将在5年内分配给国务院，与美国国际开发署等合作，旨在与外国政府合作伙伴协调通讯、电信、半导体技术等先进技术的协作。 |

资料来源：芯谋研究、德邦研究所

图 1：美国芯片法案资金分配情况 (美元)



资料来源：集微咨询、德邦研究所

美国法案预计将提升各国对半导体行业重视程度，有望加速我国推进半导体自主可控进展。首先，美国法案显示了其对于半导体环节的重视，例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造，而在研发方向上也包括国家半导体技术中心、先进封装制造等。美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。另一方面，美国芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资的先进制程投资的限制。这将进一步提升半导

体制造中自主可控的重要性，加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。

2. 风险提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦风险。

信息披露

分析师与研究助理简介

陈海进，电子行业首席分析师，6年以上电子行业研究经验，曾任职于民生证券、方正证券、中欧基金等，南开大学国际经济研究所硕士。电子行业全领域覆盖。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

| 1. 投资评级的比较和评级标准： | 类别 | 评级 | 说明 |
|--|--------|------|--------------------------------|
| 以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅； | 股票投资评级 | 买入 | 相对强于市场表现 20%以上； |
| | | 增持 | 相对强于市场表现 5%~20%； |
| | | 中性 | 相对市场表现在-5%~+5%之间波动； |
| | | 减持 | 相对弱于市场表现 5%以下。 |
| 2. 市场基准指数的比较标准： A 股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。 | 行业投资评级 | 优于大市 | 预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上； |
| | | 中性 | 预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间； |
| | | 弱于大市 | 预期行业整体回报低于基准指数整体水平 10%以下。 |

法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。